附件

產學合作計畫申請書

# 一、計畫主要研究人力

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 姓名 | 服務機構/系所 | 職稱 | 連絡電話/手機 | 電子郵件地址 |
| 主持人 |  |  |  |  |  |
| 共同主持人 |  |  |  |  |  |
| 共同主持人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 二、計畫名稱：

# 三、計畫目標：

# 四、計畫的技術挑戰、創新與未來之應用(若為前一年延續計畫，亦請敘明關聯性)：

# 五、執行計畫所需檢測分析技術與經費補助之評估

1. 計畫審定通過後，閎康科技根據計畫主持人所提供之資訊，以分析項目與執行方案評估最終補助經費，閎康科技得要求不限下表之詳細計劃內容與步驟。(範例可刪改)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 分析項目 | 執行方案 |
| 範例 | 寬能隙材料的摻雜成份縱深分析 | 以SIMS進行摻雜成份之分析 |
| 範例 | 寬能隙材料微觀結構之樣品製備與分析 | 以FIB製備樣品及TEM影像分析 |
| 範例 | 樣品晶體取向分析 | 以EBSD進行分析 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 若為延續計畫，請提供前一年度的經費核銷比例(若無則免填)：

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 占比(%) |
| 檢測費 |  |
| 管理費 |  |
| 其他 |  |

# 六、預期可分享給閎康科技之研究方法或成果：

# 七、智慧財產權之分配使用 (選題作答)

本計畫所衍生之智慧財產權之分配使用得在閎康與各校服務中心之簽約自行定義；如無特別考量，以雙方均分共有為原則。

# 八、本計畫主持人聲明

本計畫是否(曾)接受或擬向其他機構、單位或公司**申請**補助？ □ 是 □ 否；如「是」，請敘明機構、單位或公司與計畫之名稱：

# 九、請簡述主要研究人力個人學經歷，並提供2到3件代表性著作或論文供參